



平成 28 年 3 月 4 日

各 位

会社名 兼 松 株 式 会 社
 代表者 代表取締役社長 下嶋 政幸
 (コード番号 8020 東証1部)
 問合せ先 広報・IR室長 渡部佳津子
 (電話番号 03-5440-8000)

第1回および第2回無担保社債発行に関するお知らせ

本日、当社は第1回および第2回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

今回の社債発行代わり金は、当社の 100%子会社である兼松テレコム・インベストメント株式会社による株式会社ダイヤモンドテレコムの吸収合併に伴う買収資金の一部に充当する予定です。なお、当社としては約 20 年ぶりの普通社債発行であることから、本社債の名称を第1回および第2回無担保社債としております。

記

1. 銘柄名	兼松株式会社第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	兼松株式会社第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 発行額	50 億円	50 億円
3. 各社債の金額	金 1 億円	
4. 利率	年 0.40%	年 0.64%
5. 払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
6. 利払期日	毎年 3 月 10 日および 9 月 10 日	
7. 償還期日	平成 31 年 3 月 8 日 (3 年債)	平成 33 年 3 月 10 日 (5 年債)
8. 申込期日	平成 28 年 3 月 4 日	
9. 払込期日	平成 28 年 3 月 10 日	
10. 取得格付	BBB (株式会社格付投資情報センター) BBB+ (株式会社日本格付研究所)	
11. 共同主幹事会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社	
12. 財務代理人、発行代理人および支払代理人	株式会社三菱東京UFJ銀行	
13. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	

尚、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以 上